



推奨基板取付け寸法
 PC 基板厚: 1.6±0.1
 (非累積公差)
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 色: 黒
 コネクタ: 銅合金
 リテンションレグ: 銅合金
 - めっき: コネクタ: 全面Ni下地
 接触部: 0.38μm MIN金めっき
 - めっき: コネクタ: 全面Ni下地
 接触部: 0.76μm MIN金めっき
 - めっき: コネクタ: 全面Ni下地
 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
 - めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部
 ニッケル下地の土に半田めっき
 - めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部
 ニッケル下地の土にスズめっき

△6	△4	178308-5
△6	△3	178308-3
△6	△2	178308-2
(FINISH)		部品番号 (PART NO.)

				Copyright © 1993 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME		ダイナミック D3100 水平タイプ 20ピンヘッダーセンプリ			
[C] REVISED (PJ00-0099-03)		T S M 4/2		MATERIAL		FINISH		20 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASSY FOR DYNAMIC 3100	
[B] REVISED (PJ00-0114-03)		T S M 1/23		SEE NOTE		SEE NOTE		GENERAL TOLERANCE	
[A] REVISED (PJ00-2183-95)		K I SM 9/23		DR: 20-JAN-93		DE: 20-JAN-93		SIZE LOC NUMBER	
[O] RELEASED (PJ00-0017-93)		Y T S M 2/8-193		CHK: Y. TANAKA		APP: Y. TANAKA		SCALE	
LTR		REVISION RECORD		DR		CHK		APP	
		DATE		8-FEB-93		8-FEB-93		SCALE	
				S. MANABE		S. MANABE		SCALE	
								A3 J C-178308	
								REV. C	
								SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面